

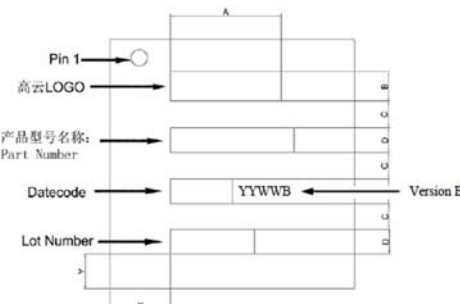
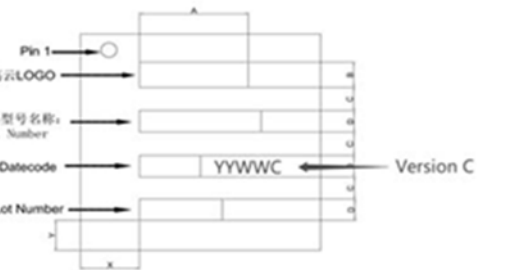
高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了适应更多场合和领域的应用，器件正常升级和优化。

描述

GW2A(R)-18 产品增加器件型号 GW2A(R)-18C ， GW2A(R)-18B 仍保留。

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更前 | <ol style="list-style-type: none">1、 器件型号：GW2A(R)-18B；2、 GW2A(R)-18B 器件日期码（丝印及标签）的第 5 位字母为“B”，如下： 3、 GW2A(R)-18B 性能：<ol style="list-style-type: none">a) PLL 抗电源噪声能力较弱。b) BSRAM 部分模式应用影响时序。 |
| 变更后 | <ol style="list-style-type: none">1、 增加器件型号：GW2A(R)-18C（保留 GW2A(R)-18B）；2、 GW2A(R)-18C 器件日期码（丝印及标签）的第 5 位增加字母“C”，如下： 3、 GW2A(R)-18C 器件性能：<ol style="list-style-type: none">a) PLL 抗电源噪声能力增强。b) BSRAM 部分模式下性能改善，节约逻辑资源。 |

受影响的产品

器件型号为 GW2A(R)-18B 及 GW2A(R)-18C 的产品。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2020 年 05 月 20 日开始执行，当前产品的 LTB 为 2020 年 05 月 19 日，LTS 为 2020 年 11 月 19 日。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

| 日期 | 版本 | 说明 |
|------------|-----|-------|
| 2019/11/18 | 1.0 | 初始版本。 |

版权所有©2019 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。